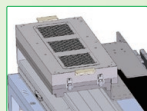


RSH-8iF



■多様な製品サイズ・形態に対応

Compatible with Various Product Sizes and Type.

Full panel, Quarter panel, Strip, Unitなど、各種サイズおよび形状に柔軟に対応可能です。

Full panel, Quarter panel, Strip, Unit and more.

■様々なバンプ形状に対応

Supports a Wide Range of Bump Shapes.

Cu-pillar (円形/角形/L字形など)、Coin bump、Round bump など、各種バンプ構造の検査に対応しています。

It supports inspection of various bump structures such as Cu-pillar (circular/square/L shape, Coin bump, Round bump, etc.).

■1.5倍以上のスピードで、生産性を飛躍的に向上※

1.5x Faster for Exceptional Productivity!

検査速度とUPHが大幅に向上し、業界トップクラスのスループットを実現。
Significantly increased inspection speed and UPH for industry-leading throughput.

■高精度・高分解能のままコストを最適化※

High Precision&Resolution, Same Cost!

従来機種と同等の材料コストで、高解像度検査と高精度な測定性能を両立。

It combines high-resolution inspection and high-precision measurement performance at the same material cost as conventional models.

■大型基板・高密度バンプに完全対応

Fully Compatible with Large Panels&High-Density Bumps.

より大きな基板や多数のバンプ、小径バンプや狭ピッチ、さらに様々なバンプ形状・方向にも柔軟に対応可能。
It can flexibly accommodate larger substrates, numerous bumps, small-diameter bumps, narrow pitches, and various bump shapes and directions.

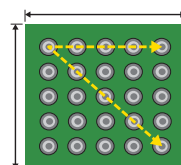
■最先端のソフトウェア&アルゴリズム搭載

Equipped with Cutting-Edge Software and Algorithms.

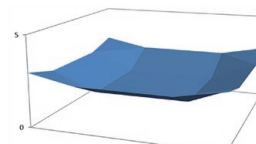
マルチコアや先端パッケージ向けTTV/STV計測など、強力な解析機能を搭載。
Powerful analysis including multi-core and advanced package TTV/STV measurements.

※弊社の現行機種との比較結果 Comparison based on our current model

3D/2D Bump Metrology

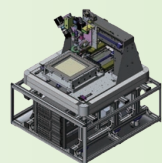


■ Large Body Size



■ Warpage

RSH-50



■既存最大機種RSH-23の2倍の視野範囲(FOV)を実現

Twice the Field of View (FOV) of our largest current model RSH-23.

当社最大機種であるRSH-23と比較して、2倍の視野範囲を持ち、より高速かつ効率的なパレージを可能にします。

Compared to our largest RSH-23, it has twice the viewing range, Enables faster and more efficient coverage.

■2倍以上のスピードで、生産性を飛躍的に向上※

More than 2x Faster – Dramatic Boost in Productivity※

検査速度とUPHが大幅に向上し、業界トップクラスのスループットを実現。
Significantly increased inspection speed and UPH for industry-leading throughput.

■大型基板に完全対応

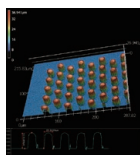
Full Compatibility with Large Substrates.

基板の大型化に伴う反りの検査を実現。(4mm以下)

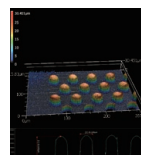
Inspection of warpage accompanying the enlargement of the substrate is realized. (4mm or less)

※弊社の現行機種との比較結果 Comparison based on our current model

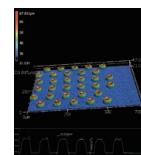
Fine Pitch Bump Measurement



■ SRO 14μm



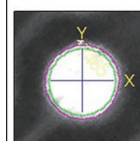
■ SRO 21μm



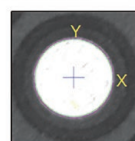
■ SRO 35μm

Various bump shapes and orientations

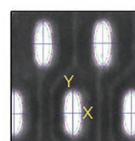
Measurement Direction



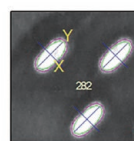
Circle post



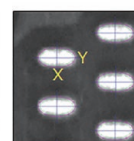
Circle IOP post



Oblong post(0°)



Oblong post(45°)



Oblong post(90°)

仕様 | Specifications

	RSH-8iF	RSH-50
FOV (μm)	9.6	46.5
Minimum bump size (μm)	20	
Minimum bump pitch (μm)	20	
3D Resolution (μm)	5	18.2
2D Resolution (μm)	0.91	9.13
Application	Bump/C4 area measurement	Substrate warpage Substrate body size

国内拠点

・京都(本社)
617-0003 京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106
・名古屋
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685
・東京
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

海外拠点

・台湾
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION
・韓国
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.
・中国
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION
・タイ
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.
・マレーシア
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
・ベトナム
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
・インド
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
・カナダ
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION